

The following specific ROO will apply for the tariff headings listed below under Chapters 84 and 85 of the Mercosur's NCM:

8443.32.11 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8443.32.12 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8443.32.13 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem

8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8443.32.19 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8443.32.21 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8443.32.22 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)

Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8443.32.23 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8443.32.29 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8443.32.35 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con

los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8443.32.39 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8443.32.51 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8443.32.59 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y

mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8443.99.11 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. REQUIREMENT: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8443.99.

8443.99.13 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8443.99.19 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8443.99.21 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No

desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8443.99.24 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8470.50.11 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8470.50.19 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por

terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem “A” y “B”. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.30.12 MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen las funciones de procesamiento y memoria, las controladoras de periféricos para teclado, y unidades de discos magnéticos y las interfases de comunicación en serie y paralela acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete, placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener el montaje y soldadura de todos sus componentes; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem “A” y “B” anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Pantalla ("display") de los ítem 8473.30.91 y 8473.30.92; y 2) Teclado del ítem 8471.60.52. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete.

8471.30.19 MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen las funciones de procesamiento y memoria, las controladoras de periféricos para teclado, y unidades de discos magnéticos y las interfases de comunicación en serie y paralela acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete, placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener el montaje y soldadura de todos sus componentes; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem “A” y “B” anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Pantalla ("display") de los ítem 8473.30.91 y 8473.30.92; y 2) Teclado del ítem 8471.60.52. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete.

8471.30.90 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem “A” y “B” anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1)

Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.41.90 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.50.10 UNIDADES DIGITALES DE PROCESAMIENTO DE PEQUEÑA CAPACIDAD. REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementan las funciones de procesamiento y memoria y las siguientes interfases: en serie, paralela, de unidades de discos magnéticos, de teclado y de video, acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener un montaje y soldadura de todos los componentes. B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" e "B" anteriores. No desnaturaliza el cumplimiento del Régimen de Origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación. En las unidades digitales de procesamiento.

8471.50.20 UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE. REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen como mínimo 3 (tres) de las 5

(cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria; c) unidad de control integrada/interfase o controladoras de periféricos; d) soporte y diagnóstico de sistema; e) canal o interfase de comunicación con unidad de entrada y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4 (cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones; B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso, establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones del mercado.

8471.50.30 UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE. REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen como mínimo 3 (tres) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria; c) unidad de control integrada/interfase o controladoras de periféricos; d) soporte y diagnóstico de sistema; e) canal o interfase de comunicación con unidad de entrada y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4 (cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones; B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso, establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones del mercado.

8471.50.40 UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MUY GRANDE. - REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen por lo menos 2 (dos) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria c) unidad de control integrada/interfase; d) soporte y diagnóstico de sistemas; e) canal de comunicación, o alternativamente, el montaje de por lo menos 3 (tres) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones; B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones de mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM", de los ítem 8473.30.42 o 8473.50.50.

8471.50.90 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.60.52 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.60.53 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No

desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.60.59 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.60.61 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.60.62 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem

8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.60.80 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.60.90 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.70.12 DISCOS DUROS. - REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B"; D. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B",

y E. Para la producción de discos magnéticos duros con capacidad de almacenaje superior a 1 (un) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) no formateado, podrá optarse entre cumplir con lo dispuesto en los ítem "A" o "B" y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el ítem "A" deberán ser soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicación con la unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y grabación; c) o lectura y grabación.

8471.70.19 DISCOS DUROS. - REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B"; D. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B", y E. Para la producción de discos magnéticos duros con capacidad de almacenaje superior a 1 (un) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) no formateado, podrá optarse entre cumplir con lo dispuesto en los ítem "A" o "B" y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el ítem "A" deberán ser soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicación con la unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y grabación; c) o lectura y grabación.

8471.70.39 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.70.90 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con

los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.80.00 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.90.11 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.90.12 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y

mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.90.13 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.90.19 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8471.90.90 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8472.90.10 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8472.90.21 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No

desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8472.90.29 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8472.90.59 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8473.29.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. REQUIREMENT: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8443.99.

8473.29.90 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1)

Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8473.30.11 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8473.30.19 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8473.30.31 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de

circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8473.30.39 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8473.30.41 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. REQUIREMENT: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8443.99.

8473.30.42 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2. - REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso.

8473.30.49 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. REQUIREMENT: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8443.99.

8473.30.99 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8473.40.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. REQUIREMENT: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8443.99.

8473.50.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. REQUIREMENT: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8443.99.

8473.50.32 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8473.50.39 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con

los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2. - REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso.

8473.50.90 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8511.80.30 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por

terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem “A” y “B”. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8517.12.11 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.12.12 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.12.13 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.12.19 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.12.21 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.12.22 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas

y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.12.23 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.12.29 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.12.31 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.12.33 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.12.39 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.12.41 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.12.49 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.12.90 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.18.20 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.61.11 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.61.19 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.61.20 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.61.43 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y

soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.61.49 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.61.91 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.61.92 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.61.99 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.11 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.13 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas

y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.14 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.19 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.21 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.22 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.23 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.24 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.29 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.31 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.32 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.33 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.41 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.48 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.51 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y

soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.53 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.55 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.61 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.62 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.63 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.71 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas

y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.72 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.79 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.91 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.93 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.94 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No

desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8517.62.95 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.62.96 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.70.92 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8517.70.99 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8518.10.10 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8518.29.10 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8523.52.00 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS.
REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8523.59.10 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8525.50.19 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8525.50.29 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8525.60.10 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8525.60.90 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8528.41.10 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8528.41.20 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8528.51.10 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No

desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8528.51.20 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8528.61.00 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8529.90.12 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. REQUIREMENT: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.

8529.90.19 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8531.20.00 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8537.10.11 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8537.10.19 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No

desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8537.10.20 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8540.50.20 REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8541.10.22 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.

8541.10.29 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS.
REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8541.10.92 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS.
REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8541.10.99 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS.
REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8541.29.20 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS.
REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8541.30.21 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS.
REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la

pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8541.30.29 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS.
REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8541.40.16 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS.
REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8541.40.21 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS.
REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8541.40.22 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS.
REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8541.40.26 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS.
REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;

D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8541.40.31 CELULAS FOTOVOLTAICAS. REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico referente a etapas de división, texturización y metalización; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; y D. Marcación (identificación);

8541.40.32 CELULAS FOTOVOLTAICAS. REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico referente a etapas de división, texturización y metalización; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; y D. Marcación (identificación);

8541.50.20 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8542.32.21 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8542.32.29 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8542.32.91 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS.
REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8542.33.90 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS.
REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8542.39.39 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS.
REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8542.39.99 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS.
REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas “A” y “B” anteriores.

8543.70.12 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8543.70.14 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8543.70.15 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8543.70.19 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8543.70.39 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8543.70.91 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8543.70.92 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8543.70.99 REQUIREMENT: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y

soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8544.70.10 CABLES ÓPTICOS. REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descritas en los ítem “A” y “B” por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el REQUIREMENT específico de origen definido para las mismas.

8544.70.30 CABLES ÓPTICOS. REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descritas en los ítem “A” y “B” por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el REQUIREMENT específico de origen definido para las mismas.

8544.70.90 CABLES ÓPTICOS. REQUIREMENT: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descritas en los ítem “A” y “B” por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el Requisito específico de origen definido para las mismas.